

公司代码：603290

公司简称：斯达半导

斯达半导体股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.08元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为239,473,466股，本次预计派发现金红利121,652,520.73元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.02%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	斯达半导	603290	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	李君月
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号
电话	0573-8258 6699	0573-8258 6699
传真	0573-8258 8288	0573-8258 8288
电子信箱	investor-relation@powersemi.com	investor-relation@powersemi.com

2、 报告期公司主要业务简介

功率半导体是半导体分立器件的重要组成部分，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，

是进行电能处理的核心器件，弱电控制与强电运行间的桥梁，细分产品主要有 IGBT、MOSFET、BJT 等。随着全球“双碳”目标驱动节能减排需求持续升级，功率半导体应用场景已从传统工业控制、4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域，快速渗透至新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等领域，成为清洁能源转型与终端产品升级的核心支撑。受益于新能源汽车行业、新能源发电及储能行业需求的快速增长以及以 AI 为代表的新兴行业爆发性增长，功率半导体行业正迎来多重利好叠加的黄金发展期。

2025 年，全球汽车电动化进程持续提速，汽车市场稳步增长，新能源汽车成为核心增长引擎。根据 EVTank 数据，2025 年全球汽车销量约 9,980 万辆，新能源汽车销量 2,354.2 万辆，同比增长 29.1%，其中新能源乘用车销量 2,271 万辆，同比增长 27.0%，渗透率约 23.5%。根据中国汽车工业协会数据，2025 年中国汽车销量 3,440 万辆，同比增长 9.4%，新能源汽车销量达 1,649 万辆，同比增长 28.2%，占全球新能源汽车销量比重达 70.3%，中国市场是全球电动化转型的核心引擎。乘用车方面，2025 年中国乘用车销量 3,010.3 万辆，同比增长 9.2%，其中新能源乘用车销量 1,553.7 万辆，新能源乘用车渗透率达 51.6%。功率半导体作为汽车电子的核心器件，是新能源汽车主驱逆变器、车载充电机、DC/DC 转换器等高压系统的不可或缺的核心零部件，新能源汽车的持续快速增长给功率半导体带来广阔的增量空间。

2025 年，全球能源低碳转型提速，清洁能源成为全球能源结构升级的核心增长引擎，新能源发电和储能行业持续快速发展。根据 IRENA（国际可再生能源署）数据，2025 年全球新增光伏装机约 511GW，同比增长 27.2%，再创历史新高；全球新增风电装机约 159GW，同比增长 14%；2025 年全球新型储能新增装机达到 113.3GW/305.8GWh，同比增 52.9%/72.0%海外清洁能源市场化建设持续推进，储能配套需求快速释放。根据国家能源局官方统计数据，2025 年国内新能源产业保持高景气发展态势，全国新增光伏发电装机 317GW，同比增长 14%；新增风电装机 120GW，同比增长 51%；中国新型储能新增装机连续四年位居全球首位，2025 年新增投运新型储能项目规模达到 66.4GW/189.5GWh，同比增长 51.9%/72.6%，在全球市场的占比达到 58.6%。国内风光储新增装机规模稳居全球首位，持续引领全球清洁能源转型进程。功率半导体作为能源电力领域的核心器件，广泛应用于光伏逆变器、风电变流器、储能变流器（PCS）等关键设备，是新能源发电与储能系统不可或缺的核心零部件。新能源发电和储能行业的持续快速发展，为功率半导体行业带来广阔的增量空间。

2025 年，AI 数据中心（AIDC）与算力中心建设规模化提速，新一代算力架构持续升级，工业及人形机器人、低空/高空飞行器等新兴应用场景加速落地，构筑了功率半导体行业全新应用赛道。①生成式 AI 技术快速普及，带动全球高密度算力需求持续攀升，AI 服务器单机功率、机柜供电密度大幅提升，高压化、高频化、高效率供电成为行业发展趋势。功率半导体作为服务器电源、母线配电模块、能源管理单元的核心基础器件，承担电能变换、稳压调控、能效优化等关键功能，算力设施的升级迭代显著拉高高性能功率器件单机用量与搭载规格。②工业及人形机器人领域，智能制造转型深化推动工业机器人渗透率稳步提升，人形机器人逐步实现场景化落地，设备运动控制、关节驱动、电源管理等环节，均依赖功率半导体实现精准电能调控与高效能量转换，行业发展对功率器件的小型化、高可靠、低损耗性能提出更高要求。③低空/高空飞行器领域，电动化、智能化、轻量化发展趋势明确，电动飞行器、高端工业无人机等产品的电推进系统、机载电源控制系统，需依托高性能功率半导体保障运行能效与作业稳定性。整体来看，新兴产业技术革新与场景渗透持续拓宽功率半导体应用边界，下游设备功率等级提升、能效标准升级、电控系统集成化发展，将持续催生刚性需求，为功率半导体行业未来长期发展提供充足增量支撑。

（一）主要业务、主要产品及用途

1. 主要业务

公司主营业务是以 IGBT、SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴，在上海、浙江、重庆和欧洲均设有子公司，并在国内和欧洲均设有研发中心。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为“C39”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”。

2. 主要产品及用途

公司长期致力于为高能效、绿色化和智能化应用提供全面的半导体及系统解决方案，产品组合覆盖 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、快恢复二极管等功率半导体器件以及汽车级与工业级 MCU、栅极驱动 IC 芯片等，广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。2025 年，IGBT 模块的销售收入占主营业务收入的 83.69%，是公司的主要产品。

作为电力电子第三次革命的核心代表，IGBT、SiC 和 GaN 等功率半导体器件被誉为工业控制与自动化领域的“心脏”，承担对电压、电流、频率、相位等关键参数的高效调控。2024 年，公司正式成立 MCU 事业部，专注于高端工规与车规级主控 MCU 的研发。MCU 作为电子设备的“大脑”，负责信号处理、逻辑判断与系统控制，实现对功率半导体等执行单元的精准调度。而栅极驱动 IC 则扮演“神经中枢”的关键角色，负责将 MCU 发出的控制信号进行放大与调理，以高效、可靠地驱动 IGBT、SiC、GaN 等功率器件，确保“大脑”指令的准确执行与系统的快速响应。

MCU、功率半导体与栅极驱动 IC 三者的协同，构建起智能化系统中至关重要的“脑-心-神经”协同架构。这一完整产品链弥补了当前国内产业链的关键短板，进一步增强了公司为客户提供系统级解决方案的能力，有助于为下游行业提供更高性能、更优成本、更快响应的一体化解决方案，尤其在新能源、新能源汽车、机器人、低空/高空经济、AI 服务器电源、数据中心等高速增长领域，形成显著的技术协同与竞争优势，为公司持续引领行业创新注入新动能。

（二）经营模式

公司以市场需求为导向、以技术研发为核心支撑，依托芯片端“Fabless+IDM 双轮驱动”的发展模式，实现芯片设计与工艺自主可控、制造柔性布局、资源高效配置；同时发挥模块端自主设计、生产、测试的全流程管控优势，精准匹配下游多元化应用场景，为客户提供具有竞争力的功率半导体器件及配套系统解决方案。

公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片制造、模块生产三个阶段。

阶段一：芯片和模块设计。公司产品设计涵盖 IGBT、快恢复二极管、SiC MOSFET 等芯片设计及功率模块设计。本阶段，公司根据客户对芯片关键参数的需求，设计符合客户性能要求的芯片；同时，结合客户对电路拓扑、模块结构的需求及功率模块电性能、可靠性标准，设计满足各行业应用需求的功率模块。

阶段二：芯片制造。目前，公司芯片制造依托“Fabless+IDM 双轮驱动”模式：一方面，公司芯片主要委托上海华虹、上海积塔等第三方晶圆代工厂商外协制造，公司提供芯片设计图纸及工艺制作流程，不直接承担芯片制造环节；另一方面，公司募投项目 SiC 芯片研发及产业化项目、高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目已完成建设并投产，形成年产 6 万片 6 英寸车规级 SiC MOSFET 芯片、30 万片 6 英寸 3300V 及以上高压特色功率芯片的生产能力。

阶段三：模块生产。模块生产是基于模块原理，将单个或多个功率芯片（如 IGBT、快恢复二极管、SiC MOSFET、GaN HEMT 等芯片）通过先进封装技术封装于绝缘外壳内的过程。本阶段，公司根据不同产品需求，通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、全流程测试等核心生产环节，全程自主管控生产工艺，最终生产出符合公司标准及客户需求的功率模块。公司核心产品 IGBT 模块、SiC MOSFET 等功率模块集成度高、内部拓扑结构复杂，且需在高电压、大电流、高温、高湿等恶劣工况下稳定运行，对公司的自主设计能力与生产工艺管控水平提出了极高要求，也彰显了公司模块端自主经营的技术优势。

公司销售以直销模式为主，可深度对接终端客户需求，快速响应定制化开发、技术支持与交

付服务，有效提升合作粘性与服务响应效率。结合下游客户分布特点，除嘉兴总部外，公司在全国布局多个销售联络处，同时，在瑞士设立控股子公司斯达欧洲，负责海外市场开拓和发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	10,569,382,470.80	9,645,676,460.22	9.58	8,483,526,496.78
归属于上市公司股东的净资产	6,938,160,143.95	6,681,947,061.23	3.83	6,435,365,819.73
营业收入	4,012,395,321.49	3,390,620,672.02	18.34	3,662,965,373.81
利润总额	442,819,349.76	606,402,331.02	-26.98	1,044,010,042.38
归属于上市公司股东的净利润	405,233,645.96	507,666,284.89	-20.18	910,525,988.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,151,608.49	487,365,563.47	-22.61	886,224,731.18
经营活动产生的现金流量净额	594,839,679.49	962,640,643.37	-38.21	382,685,708.76
加权平均净资产收益率(%)	5.96	7.8	减少1.84个百分点	15.07
基本每股收益(元/股)	1.69	2.12	-20.28	3.81
稀释每股收益(元/股)	1.69	2.12	-20.28	3.8

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	919,230,418.28	1,016,380,017.53	1,054,006,536.27	1,022,778,349.41
归属于上市公司股东的净利润	103,704,640.46	171,744,936.81	106,390,534.35	23,393,534.34
归属于上市公司股东	101,699,316.65	158,956,008.36	104,004,060.72	12,079,380.26

的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	172,654,677.15	191,698,435.40	18,672,457.66	211,814,109.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					56,910		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					57,872		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港斯达控股有限公司	0	99,773,520	41.66	0	无		境外 法人
浙江兴得利纺织有限公司	-2,387,500	27,105,971	11.32	0	无		境内 非国 有法 人
嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）	-1,726,840	6,500,490	2.71	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-982,759	2,763,866	1.15	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	1,827,879	1,827,879	0.76	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,800	1,720,840	0.72	0	未知		其他
国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有	0	1,272,726	0.53	0	未知		其他

有限合伙)							
李晓春	33,580	786,156	0.33	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	754,940	754,940	0.32	0	未知		其他
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-595,915	745,990	0.31	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

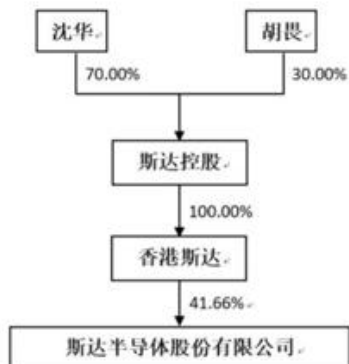
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年，公司依托深厚技术积淀与行业领先地位，聚焦核心业务，充分发挥“Fabless+IDM 双轮驱动”业务模式优势，同步推动驱动 IC、工业级及车规级 MCU 芯片与现有功率半导体业务深度协同融合，持续提升核心竞争力与长期发展潜力。

报告期内，公司实现营业收入 401,239.53 万元，创历史新高，实现归属于上市公司股东的净利润 40,523.36 万元，较去年同期下降 20.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,715.16 万元，较去年同期下降 22.61%。

报告期内，公司新能源汽车、新能源发电及储能、变频白色家电行业快速增长，为公司营业收入增长提供核心支撑。同时，公司积极开拓 AI 服务器电源、数据中心、工业机器人、低空/高空飞行器等新兴应用领域，持续拓展产品应用边界，为公司业务增长开辟全新空间。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用